深圳市科技创新委员会2024年度集成电路

专项资助计划项目申请指南

一、申请内容

（一）对集成电路设计企业流片支持

1.多项目晶圆直接流片资助；

2.首次完成全掩膜工程产品流片资助。

（二）对集成电路设计企业购买IP（硅知识产权）支持

对于企业购买IP开展高端芯片研发，给予IP购买费用资助。

（三）对集成电路EDA设计工具研发支持

对于从事集成电路EDA设计工具研发的企业，给予EDA研发费用资助。

二、设定依据

（一）《深圳市人民政府关于印发进一步推动集成电路产业发展行动计划（2019-2023年）的通知》(深府〔2019〕28号)；

（二）《深圳市人民政府办公厅关于印发加快集成电路产业发展若干措施的通知》（深府办规〔2019〕4号）。

（三）《深圳市科技计划项目管理办法》(深科技创新规〔2019〕1号；

（四）《深圳市科技研发资金管理办法》(深科技创新规〔2019〕2号)；

三、支持强度与方式

支持强度：有数量限制，受科技研发资金年度总额控制。按照**审计结果**确定资助额度，本批次资助资金由2024年度市级财政资金和中央引导地方资金组成。

（一）对集成电路设计企业流片支持

1.对于使用多项目晶圆进行研发的企业，给予2022年多项目晶圆直接流片费用最高70%、年度总额不超过300万元的资助；

2.对于首次完成全掩膜工程产品流片的企业，给予2022年首次完成全掩膜工程产品流片费用最高50%、年度总额不超过500万元的资助。

（二）对集成电路设计企业购买IP支持

对于购买IP开展高端芯片研发的企业，给予2022年IP购买实际支付费用最高20%的资助，单个企业每年总额不超过500万元。

（三）对集成电路EDA设计工具研发支持

对于从事集成电路EDA设计工具研发的企业，给予2022年EDA研发费用实际支出最高30%的研发资助，总额不超过3000万元。

支持方式：事后资助。

四、申请条件

（一）基本条件：

1.申请单位应当是在深圳市（含深汕特别合作区，下同）依法注册，具备法人资格的企业；

2.申请单位应在深圳具备研发的场地、设施、人员等；

3.申请单位未被列入深圳市科研诚信异常名录和超期未申请验收名单；

4.项目申请单位不存在未在规定期限内退回财政资金的情形；

5.申请单位同一项目不得向市有关部门进行多头申请和重复申请；

（二）专项条件：

1.对集成电路设计企业流片支持

（1）申请单位应为集成电路设计企业；

（2）申请单位应为流片产品的知识产权所有方；

（3） 项目未申请市发展改革委集成电路设计流片扶持计划。

2.对集成电路设计企业购买IP支持

（1）申请单位应为集成电路设计企业；

（2）申请单位应为IP授权协议中的知识产权最终被授予方，且不再转售予第三方；

（3）IP购买实际支付费用应为IP授权费用（不含版税费用）。

3.对集成电路EDA设计工具研发支持

（1）申请单位应为从事集成电路EDA设计工具研发企业；

（2）研究开发活动应符合研发费用加计扣除政策范畴，且2022年度已向税务部门办理加计扣除申报。

五、申请材料

（一）基本材料：

1.2022年度纳税证明复印件；

2.经注册会计师行业统一监管平台备案的含有二维验证码封面的的2022年度研发投入专项审计报告复印件（报告应包含资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表及附注、集成电路设计（或EDA设计工具研发）的研发场地、研发团队、软硬件设施、研究开发费用及经费来源等内容），研究开发费用计算范围和计算比例按照《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119号）、《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第40号）等政策文件的规定执行；

3.知识产权合规性声明原件;

4.科研诚信承诺书原件；

5.可以选择提供集成电路设计（或EDA设计工具研发）相关的知识产权证(例如专利和软件著作权等)证明材料复印件。

（二）专项材料：

1.对集成电路设计企业流片支持

（1）深圳市集成电路专项资助计划流片及IP资助项目申请书原件；

（2）境内加工产品需提供：集成电路制造企业出具的2022年度产品加工发票及相应的加工订单、银行支付凭证、记账凭证等复印件；

境外加工产品需提供：加工订单、银行支付凭证、相应记账凭证、集成电路制造企业出具的2022年度产品加工交货invoice和交货箱单、相应清关凭证或完税证明复印件、申报数据的明细表（列明申报金额与合同金额（外币）、发票金额（外币）、付款金额（外币）的计算基础）。

（3）通过专业服务机构流片的申请单位需另外提供专业服务机构与申请单位签署的合同、发票、银行支付凭证等复印件;

**（每个产品的加工订单、加工发票、银行支付凭证、清关凭证/完税证明应依次排序成一个文件，按照业务系统申报顺序标明序号。英文合同/订单请提供中文翻译件）**

（4）产品版图缩略图A4版彩色打印件；

（5）首次全掩膜产品流片需提供该产品布图设计登记证书复印件。

2.对集成电路设计企业购买IP支持

（1）深圳市集成电路专项资助计划流片及IP资助项目申请书原件；

（2）2022年度购买IP的发票及相应的合同、银行支付凭证等复印件，购买进口IP的另需提供相应的完税证明复印件；

（3）合同不含IP原厂授权条款的，需提供申报企业与IP原厂直接签署的IP授权协议复印件。

**（每个产品的合同/授权协议、发票、银行支付凭证、完税证明应依次排序成一个文件，按照业务系统申报顺序标明序号。英文合同/授权协议请提供中文翻译件）**

3.对集成电路EDA设计工具研发支持

深圳市集成电路专项资助计划EDA设计工具研究开发资助项目申请书原件。

六、申请表格

本指南规定提交的表格，申请单位登录深圳市科技业务管理系统在线填报。

七、受理机关

（一）受理机关：深圳市科技创新委员会。

（二）受理时间：

网络填报受理时间：2023年9月11日-2023年10月29日（截止24:00）。

申请单位在网上填报受理时限内登录深圳市科技业务管理系统在线填报《深圳市集成电路专项资助计划项目申请书》，并在科技业务系统中上传其他申请材料的电子版扫描件（复印件需加盖申请单位公章后扫描）后提交审核（系统受理状态为“待窗口受理”）。

（三）书面材料提交时间：项目入库后提交纸质书面材料，具体提交时间和方式另行通知。

（四）联系电话：86168829、86168680

技术支持：86576087、86576088

八、决定机关

深圳市科技创新委员会。

九、办理程序

网上申报——电子材料初审——委托审计——项目审定——社会公示——项目入库——下达计划——提交纸质材料——拨付资金。

十、办理时限

成批处理。

十一、证件及有效期限

证    件：批准文件。

有效期限：申请单位在收到批准文件之日起1个月内办理资金拨付。

十二、法律效力

申请单位凭批准文件获得市科技研发资金资助。

十三、收费

不收费。

十四、年审或年检

无年审。

**声 明：**申请人和申请单位对申请材料的合法性、真实性、准确性和完整性负责。对抄袭剽窃或弄虚作假的，我委核实后将不予立项或撤销项目，并纳入科研诚信异常名录，同时视情节轻重，依法依规追究相应责任。

**市科技创新委从未委托任何单位或个人为项目申请单位代理资金申请事宜，申请单位必须自主申请。凡是购买、委托代写项目申请书的，或是提供虚假证明材料的，一经发现并查实，即视为骗取财政资金，一律不予受理、取消申请资格或撤销立项项目，并按规定严肃处理。市科技创新委将严格按照有关标准和程序受理，不收取任何费用。如有任何中介机构和个人假借市科技创新委领导和工作人员名义向申请单位收取费用的，请知情者即向市科技创新委举报。**

**项目申请单位需提交审计报告的，应当按照《深圳市科技计划项目管理办法》等规定，提供经注册会计师行业统一监管平台备案的含有二维验证码封面的的审计报告。项目申请单位提供无防伪标识封面（未备案）或属于虚假防伪标识封面（未备案）的审计报告，市科技创新委员会不予采用。 相关审计报告经核查认定属于虚假材料的，项目单位五年内不得申请市科技计划项目，市科技创新委员会将其列入科研诚信异常名录，并按照市政府失信联合惩戒有关规定予以处理。**

**特别说明：**

1. **本指南中的多项目晶圆（MPW），指晶圆加工厂组织的、多个使用相同工艺的、不同的集成电路设计项目放在同一晶圆片上流片,每个设计项目样品数为数十颗或数百颗芯片；**
2. **首次全掩膜工程产品流片（FullMask），指集成电路设计项目第一次全部层次制版流片，不包括改版；**
3. **IP（硅知识产权、集成电路IP核），指具有知识产权的、经过验证的、可重复利用、非独家授权的集成电路模块；**
4. **专业服务机构特指专业从事流片服务、或从事包含流片服务业务的集成电路设计服务企业或单位；**
5. **晶圆加工厂和掩膜厂出具的发票（境外为交货invoice）、IP供应商出具的发票（境外为交货invoice）均应为2022年度，其他相关票据不限时间但应符合逻辑。**